

耐高温导热硅脂

TG300是一款具有高导热系数耐高温的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料，耐热性、长效性、可靠性佳，同时低BLT厚度可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻，适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。



特性和优点

- 导热系数3.0W/(m·K)
- 低游离度
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻
- 耐候性强（耐高低温、耐水气、耐老化等）

典型应用

- 存储模组
- 网络通讯设备
- 消费类电子
- 电源
- 工控设备
- 电控、OBC等汽车电子

典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
密度(g/cc)	3.3	ASTM D792
BLT(μm)	15	千分尺
挥发份(%)	<0.5	125°C,48h
粘度(cP)	103700	DV2T-T93-12Rpm
锥入度(0.1mm@25°C)	260	GB/T269
耐温范围(°C)	-40~200	/
保质期(月)	6	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥5.0	ASTM D149
体积电阻率 (Ω · cm)	1.2*10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	3.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in ² /W@50psi,80°C)	0.010	ASTM D5470